**第二十二届中国覆铜板技术研讨会**

**邀 请 书**

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会、中国电子电路行业协会覆铜板分会，拟定于2021年11月4日至11月6日，在广东省珠海市“珠海银都嘉柏大酒店”举办“第二十二届中国覆铜板技术研讨会”。

本届研讨会的主题为“**上下游携手创新，实现高端技术跨越**”。本届大会是在5G应用及新一轮科技革命和产业变革深入发展，覆铜板产业进入创新突破高质量发展新时代的背景下召开，面对新机遇、新挑战，我国覆铜板产业如何深入推进技术创新，加快高端技术突破，实现高端技术跨越，满足市场新需求。本届研讨会着重研讨技术创新突破的新进展，交流市场需求的新趋势，展现覆铜板、原材料及设备的新成果，对促进产业链健康发展具有重要的意义。

自2000年CCLA创办并每年举办的“中国覆铜板技术研讨会”，已经成为我国覆铜板制造业中最高层次的技术交流盛会，也是全面展示全球及我国覆铜板产业链新技术成果的平台。本届大会将邀请覆铜板行业及其上下游企业、研究院所的知名专家，就覆铜板技术及产业链的热门话题作深入探讨和精彩演讲，还有来自国内覆铜板行业及上下游行业的专家、技术人员呈献的优秀论文，并在大会召开期间，隆重颁发本届研讨会的“CCLA杯优秀论文奖”。

**热忱欢迎覆铜板行业及上下游企业代表、业界人士届时光临。**

**热忱欢迎关注覆铜板行业发展的各界人士、机构光临此盛会。**

**参会代表，必须遵守大会举办地政府的防疫相关规定。**

**主办单位及联络资讯：**

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 王晓艳 029-33335234

中国电子电路行业协会覆铜板分会 李 琼 021-54179011-605

**承办单位：**

山东圣泉新材料股份有限公司

**协办单位：**

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）

广东省电路板行业协会（GPCA）

深圳市线路板行业协会（SPCA）

湖南省电子电路行业协会（HNPCA）

江西电子电路行业协会（JXPCA）

台湾电路板协会（TPCA）

**赞助单位：**

山东圣泉新材料股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司

珠海镇东有限公司 江西省宏瑞兴科技股份有限公司

上海彤程电子材料有限公司 华烁科技股份有限公司

广东同宇新材料有限公司 陕西宝昱科技工业有限公司

广东生益科技股份有限公司 南通图海机械有限公司

无锡伟一不锈钢有限公司 广州君亮模具科技有限公司

成都科宜高分子科技有限公司 重庆德凯实业股份有限公司

苏州巨峰新材料科技有限公司 江苏东材新材料有限责任公司

南通凯迪自动机械有限公司 广东硕成科技有限公司

辽宁新洪源环保材料有限公司 无锡赫普轻工设备技术有限公司

江西省航宇新材料股份有限公司 江苏省通州湾江海联动开发示范区

赞助单位征集中 ••••••

**会议日程:（待定）**

“第二十二届中国覆铜板技术研讨会”：会期2021年11月4日～6日。11月4日全天报到，11月5日全天报告（8:30～18:00），11月6日疏散。

**会议费用：**

**费用包括**：会务费、资料费、餐饮费等。

**会费标准：**已交会员费单位1500元/人，未交会员费单位代表及非会员单位代表2000元/人。参会代表可提前将会务费汇至协会账户，如参会人员有变动，会后办理退费或报到现场补交。

**住 宿：**参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间，标间310元/晚/间（含双早），单间310元/晚/间（含早餐），费用自理。

**预定住宿联系人：**黄慧（经理），电话：13825694226。

**付款方式：**

**帐 户: 中国电子材料行业协会**

**开户银行: 工行北京香河园支行**

**账 号: 0200 0191 0900 0125 724**

注：提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组，收到汇款后即可开票邮寄，汇款时请附言“覆铜板会议会务费”，以便区分；现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组，以便及时开票。

**疫情防控要求：**

根据珠海市疫情防控要求，“第二十二届中国覆铜板技术研讨会”疫情防控规定如下：

1. 所有参会代表需持健康、行程绿码进入酒店；
2. 广东省以外代表，需持健康、行程绿码及48小时内核酸检测阴性报告进入酒店；
3. 会议不邀请高、中风险地区及健康、行程码异常的代表参会。

**会议地址：**

珠海银都嘉柏大酒店，地址：珠海拱北粤海东路1150号。

酒店联系电话：0756-8883388 （酒店前台）。

**会议酒店交通指南：**

**飞 机：**珠海金湾机场距会议酒店约43公里，出租车：约45分钟，费用120元左右；机场大巴：往拱北方向（珠海机场→中珠大厦）约45分钟，票价30元，中珠大厦下车 步行 5分钟到酒店。

**高 铁：**珠海站距离酒店1.3公里，出租车：约10元；公交车：拱北口岸总站，

乘坐9路公交车到银都公交站，票价2元；步行：15分钟左右。

**会务组联络方式：**

**联系人：**王晓艳 13609146084 ，029-33335234

董榜旗 15667263899

**协会微信：**15667246308

**E-mail:** [ccla33335234@163.com](mailto:ccla33335234@163.com)

**网 站：**[www.chinaccl.cn](http://www.chinaccl.cn/)

第二十二届中国覆铜板技术研讨会组委会

2021年10月 26日

**“第二十二届中国覆铜板技术研讨会”**

**会议回执**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | |  | | | | **订房数量** | |
| **代表姓名** | | **职 务** | **手 机** | **电 话** | **E-mail** | **单人间** | **双人间** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **开票信息： 名 称：**  **纳税人识别号：**  **地 址、电 话：**  **开户行及账号：**  **发票邮寄地址：** | | | | | | | |
| **备注** | 1. **房源有限，计划在珠海银都嘉柏大酒店住宿的代表，务请于2021年10月25日前自行与酒店联系预订房间！联系时请报“覆铜板行业协会会议”，即可享受优惠价格。酒店预定房间联系人：黄慧经理 电话**   **13825694226。**   1. **请参会代表准确填写回执表各项信息，**[**将回执于10月28日前发至**](http://将回执于10月15日前发至)[**ccla33335234@163.com**](mailto:ccla33335234@163.com)**或协会微信：15667246308 。** 2. **需要了解研讨会最新动态请登录：**[**www.chinaccl.cn**](http://www.chinaccl.cn) **或者直接联系会务组。** | | | | | | |

**2021年11月5日会议日程表（暂定）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **报告地点、报告人及报告题目** | **主持人** |
| **报告地点 三楼万国厅** | | |
| 8:30  ～  12:00 | 中国电子材料行业协会副理事长、覆铜板材料分会理事长 **张 东： 致开幕词** | **张 东** |
| 中国电子电路行业协会资深副理事长、CPCA覆铜板分会会长 **董晓军：致词** |
| 广东省珠海市领导 **： 致词** |
| 山东圣泉新材料股份有限公司 总裁 **唐地源： 致欢迎词** |
| 颁发“覆铜板行业技术委员会”专家聘任证书、颁发2021年“CCLA杯优秀论文奖” |
| 珠海市招商推介：**待定** |
| 华为技术有限公司PCB首席工艺专家 **高 峰： 下一代高速高频CCL基材及原材料技术需求及挑战** |
| 中国电子科技集团公司第14研究所研究员级高级工程师 **杨维生： 5G大潮引发的基板材料“趣”解读** |
| 中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 高级顾问 **师剑英： 浅析覆铜板用聚苯醚树脂的改性技术** |
| 山东圣泉新材料股份有限公司电子化学品事业部总经理 **唐爱云：拥抱变革 加速突破** |
| 毕克助剂（上海）有限公司热塑性塑料经理 **黄刘应： 毕克助剂在覆铜板中的应用** |
| 12:00～13:30 | **自助餐 二楼西餐厅** | **董榜旗**  **耿宝库** |
| **CCL产品与技术报告专场 三楼万国厅** | | |
| 13:30～  18:00 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所高级工程师 **张立欣：**  **含氟复合偶联剂对聚四氟乙烯基微波复合介质基板性能的影响** | **师剑英** |
| 广东生益科技股份有限公司、国家电子电路基材工程技术研究中心高级工程师 **茹敬宏： 环氧胶覆盖膜的溢胶研究** |
| 南亚新材料科技股份有限公司研发工程师 **殷小龙：**  **含磷阻燃马来酰亚胺树脂组合物的制备及其在高频高速覆铜板中的应用研究** |
| 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂研发工程师 **王东林： 薄型IC封装用载板基材的性能研究** |
| 陕西生益科技有限公司研发主管 **季尚伟： 双氰胺固化环氧覆铜板无DMF化研究概述** |
| 浙江华正新材料股份有限公司研发工程师 **雷恒鑫： 通过HAST快速模拟PCB基板老化插损波动性能** |
| 苏州生益科技有限公司高级工程师 **任科秘： 覆铜板基材长期耐热老化性的测试研究** |
| 中兴通讯股份有限公司高级工程师 **魏新启： 5G通讯对PCB及高速覆铜板技术要求** |
| **CCL用原材料报告专场 三楼东方厅** | | |
| 13:30～  18:00 | 中国科学院长春应用化学研究所副研究员 **郭海泉： 单层介质挠性双面覆铜板结构设计与性能** | **杨中强** |
| 山东圣泉新材料股份有限公司高级工程师 **葛成利： 低介电环氧树脂研究进展** |
| 广东同宇新材料有限公司研发工程师 **张旭： 马来酸酐封端脂肪族聚酰亚胺型双马来酰亚胺树脂合成与性能探究** |
| 华烁电子材料（武汉）有限公司总经理助理 **陈伟： 改性BT树脂的制备与性能研究** |
| 国家绝缘材料工程技术研究中心、四川东材科技集团股份有限公司研究院院长 **周友：**  **低介质损耗增韧树脂合成及其在马来酰亚胺体系中的应用** |
| 中国地质大学（武汉）材料与化学学院教授 **曾鸣：**  **羧基化石墨烯/聚（苯并噁嗪-氨酯）杂化纳米复合树脂的制备与超高频介电性能研究** |
| 中电材协覆铜板材料分会副秘书长 **祝大同： 高速覆铜板用乙烯基芳香族共聚物研发思路的剖析** |
| 18:30～20:30 | **山东圣泉新材料股份有限公司 招待晚宴 三楼万国厅** | **耿宝库** |